銀鴻科技股份有限公司
STK Corporation
www.stk-corp.com.tw
台北市松山區八德路四段678號12樓之1(台北新站大樓)
12F-1,No.678 Sec.4,Pa Teh Rd, Sung Shan Dist.,Taipei City
105,Taiwan,R.O.C.
Tel:886-2-8787-2846 Fax:886-2-8787-2845

SK-8100F25H 導熱膠帶

產品用途：

- 電子零件 IC、MOS、CPU 等與散熱機構間的導熱和黏貼材料。
- LED 背光、LED 照明、LED TV 等產品中 LED 熱源與散熱機構間之導熱介質(TIM, Thermal Interface Material)。

產品結構：

離型紙
導熱壓克力膠
玻纖
導熱壓克力膠
離型紙

產品特色：

- 黏著性良好、不殘膠。
- 柔軟可壓縮、填縫性佳。
- 導熱效能好、絕緣性佳、可耐高電壓。
- 可重工性佳、加工操作容易、長期使用不影響性能。

產品物性：

項目	SK-8100F25H (TC101)	測試方法
Carrier Type (基材)	Fiber Glass(玻纖)	-
Color (顏色)	White (白)	-
Tape Type (膠系)	Filled Acrylic Polymer (有填充物的壓克力高分子)	-
Filler Type (填充物種類)	Ceramic (導熱陶瓷粒子)	-
Tape Thickness(總厚) (mm)	0.25 ± 10%	ASTM D3652
Tensile Strength(抗張強度) (psi)	400 ± 10%	ASTM D412
Density(密度) (g/cm^3)	1.8 ± 0.2	ASTM D792
Thermal Conductivity(熱傳導係數) (W/mK)	1.1 ± 0.1	ASTM D5470
* 180 Degree Peel Test(180 度黏著力) (Kgf/in)	1.7 ± 0.1	ASTM D3330
* Holding Power (保持力) 1000g @ Room Temp. using 1 in^2 1 week	PASS	ASTM D3654
* Holding Power (保持力) 500g @ 70 ^oC using 1 in^2 1 week	PASS	ASTM D3654
Shear Strength(剪切強度) (kgf/cm^2)	6 ± 1	ASTM D1002
Initial Tack (初期力) (#14/cm)	3	PSTC-6
Surface Resistivity(表面阻抗) (Ω)	$>10^{12}$	ASTM D257
Insulation Strength(耐電壓) (KV)	>3	ASTM D149

Breakdown Voltage(破壞電壓) (KV)	>5	ASTM D149
Flammability Class (耐燃等級)	V-0	UL94
Temperature Range of Usage (操作溫度) (^{o}C)	-40~160	-
符合 RoHS 規範(RoHS Compliant)	YES	-
符合 Reach 規範(Reach Compliant)	YES	-

* 1 mil PET backing

注意事項：

1. 使用本產品之前，請先將被貼物表面上之油漬、灰塵、水、脫膜劑或其他污染物等清除，並擦拭乾淨，如此可確保本產品之黏性。
2. 黏貼本產品時，應均勻地在整個表面施加壓力，才能達到理想的黏貼效果。
3. 儲放本產品，儲放場所應避免陽光直射，並要防潮、防高溫及防止超低溫的情況；並避免和易燃、易揮發的物品放置同一地方。

保存條件：室溫 23℃, 65 % R.H

有效保存期限：12 個月

以上測試數據僅供參考，不列入驗收標準，客戶仍需依實際操作需求與使用目的，進行測試與確認。
(Vales presented have been determined by standard test methods and are average values not to be used for specification purposes. We recommend that you carry out your own test in each case, to confirm that the SK-8100Fseries thermal conductive tape which you consider using is appropriate for your particular application. Otherwise, STK shall not be any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a result of your own tests to determine their suitability for your applications)